

SH-putty3

Thermal Conductive Putty

LiPOLYのSH-putty3 シリーズは、熱伝導率：8.0 W/m*K の隙間充填材です。変形性が高く、隙間に合わせて上手く充填し、公差を補う特性も備えております。また、パティの逆流、乾かす等の問題もなく、熱がより良く伝導することができます。当社が開発のディスペンサーを使って、自動化生産ラインには適切な製品です。

■ 製品の特性

/ 熱伝導率: 8.0 W/m*K
/ 対応可能薄さ: 100-3000μm
/ 公差を補われる特性
/ 精密部品には圧力をかけず
/ 垂れせず
/ バッチ生産可能
/ 高圧縮及び低応力環境には適合

■ 製品アプリケーション

/ CPUと放熱シンクの隙間
/ PCコンポーネントと放熱
シンクの隙間
/ 高速記憶装置
/ 通信設備
/ フラットパネルディスプレイ
/ セットトップボックス
/ ネットワークカメラ
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 容量の単位

/ カートリッジ: 30ml, 55ml, 330ml
/ ペール缶: 1kg, 25kg

■ 保存期間

/ 当製品が未使用の状態
室温25度の条件には60ヶ月
が保存できます。

■ TYPICAL PROPERTIES

PROPERTY	SH-putty3	TEST METHOD	UNIT
Color	Gray	Visual	-
Resin base	Silicone	-	-
Viscosity	17000	DIN 53018	Pa.s
Flow Rate (30cc EFD tube, 2.35mm Orifice diameter, 90psi&60s)	32	By LiPOLY	g/min
Density	3.4	ASTM D792	g/cm³
Application temperature	-60~180	-	°C
Bond line thickness	100~3000	-	μm
Shelf life	60 months	-	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown	12	ASTM D149	KV/mm
Volume resistivity	>10 ¹³	ASTM D257	Ohm-m
THERMAL			
Thermal conductivity	8.0	ASTM D5470	W/m*K
Thermal impedance@10psi / 60°C	0.039	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@30psi / 60°C	0.035	ASTM D5470	°C-in²/ W
Thermal impedance@50psi / 60°C	0.031	ASTM D5470	°C-in²/ W

■ 備考

全自動ホモジナイザーを使用する場合は沈降現象が急速に改善され、均質な効果が得られます。製品は沈降現象を起こらないように、使用する前に3 ~ 5 分間の均質化してください。

注意: 製品が均質化済みの状態で 24 時間以上未使用の場合、再び使用中に再度均質化する必要があります。

■ 垂れ落ち試験

3.0mmのシートを使って、隙間調整を行う。パティをアルミ板とガラス板の間に乗せて、試験前にはパティの位置を表記し、125°Cのオーブンに1000時間ベーキングした後を取り出して、パティの位置を再確認する。



高温試験終了後
材料は元の位置からずれるかを確認する



LiPOLYのすべての仕様は予告なしに変更されることがあります。LiPOLYはTIM テスター法および ASTM D5470 試験法を LiPOLY の定義として使用しています。購入者が要求した製品の特定の目的、性能、および品質は保証されません。購入者は、使用前にその安全性を評価および検証する必要があります。また、必要な特定の条件について事前に製品をテストし、期待される性能を検証する必要があります。製品の使用および適用に対する責任はエンドユーザーにあります。LiPOLYは、目的への適合性、商品性、または特定または一般的な目的のための材料または製品の非侵害の保証を否認します。LiPOLYは、偶発的または一般的な責任、すべてのLiPOLY製品は、その時点で有効なLiPOLYの販売条件に従って販売されるものとし、そのコピーは、コンプライアンスに基づいて提供されるものとします。LiPOLY、無断複写、転載を禁じます。LiPOLYの商標、およびLiPOLYまたはその関連会社を含むすべての権利は留保されています。他の製品またはサービス名は、第三者の所有物である可能性があります。この記事のいかなる内容も、LiPOLYまたはその知的財産権に対する第三者へのライセンスを提供するものではありません。仮説または推測事項は、特許が侵害されていないことを保証するものではありません。Copyright LiPOLY